

編集後記

物性研だよりでは、研究成果だけでなく、舞台の裏側や研究者の思考のいきさつを垣間見られるのが、面白みの一つかと思います。

先端材料&研究現場で、非常に面白く読ませて頂いたのは、1件目の小林先生の記事です。小林先生のレーザー研究の概要とともに NEDO での活動は存じていたものの、研究と半導体先端分野がどのように結びついていると理解できていませんでした。また、ビルドアップ基板のフィルムを味の素から提供されたと、サラッと書かれています。数少ない私の企業とのお付き合いですが、このような先端材料が提供はなかなかして頂けなかったもので、少し驚きました。コンソーシアムのお陰でしょうか。

勝本先生の記事では、まさに試行錯誤なども含めていきさつを語って頂いております。先生には、記事の冒頭に書かれたように、是非「物性研究所」を振り返っての、ご感想や、ご意見について伺う機会があつて欲しいと思います。

今号では、8件も研究紹介があり、また、客員所員のお話があり、私の理解力が及ばないことも加わって、全てについてご紹介するのはできませんでしたが、いずれも、背景や研究のいきさつも含めて、興味深い記事となっていますので、是非、ご一読を。

鈴木博之

物性研だよりの購読について

物性研だより発行のメール連絡を希望される方は共同利用係まで連絡願います。

また、物性研だよりの送付について下記の変更がある場合は、お手数ですが共同利用係まで連絡願います。

記

1. 送付先住所変更（勤務先⇄自宅等）
2. 所属・職名変更
3. 氏名修正（誤字脱字等）
4. 配信停止
5. 送付冊数変更（機関送付分）
6. メール配信への変更

変更連絡先：東京大学物性研究所共同利用係

〒277-8581 柏市柏の葉 5-1-5

メール：issp-kyodo@issp.u-tokyo.ac.jp